

2017年1月10日

ヘンケルジャパン、カーエレクトロニクス技術展に出展 ～熱対策製品 BERGQUIST(パークイスト)開発品を初公開～

ドイツの化学・消費財メーカー ヘンケルの日本法人ヘンケルジャパン株式会社(本社:東京都品川区 社長:金井 博之)のエレクトロニクス事業部は、「第9回 国際カーエレクトロニクス技術展」(会期:2017年1月18日～20日 会場:東京ビッグサイト)に出展、熱対策製品 BERGQUIST ブランドの開発品を初公開します。

ヘンケルジャパンブースでは、ディスペンサーで塗布可能な2液混合タイプの熱伝導性ギャップ充填材料:Gap Filler(ギャップフィラー)を中心に展示、熱対策製品:BERGQUIST ブランドの豊富な採用実績や、開発品を含む多彩なラインナップを紹介し、ディスペンサー装置のデモやエアガンによる塗布体験を随時行っており、製品の選択のみならず、製造工程まで含めたトータルソリューションを提供します。

<ヘンケルジャパン 主な展示製品>

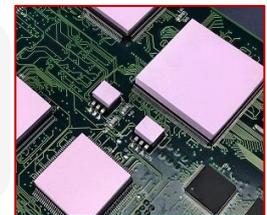
Gap Filler(ギャップフィラー)

ディスペンサーで塗布可能な2液混合タイプの液状熱伝導性ギャップ充填材料。ディスペンサーで塗布出来るため形状自由度が高く、また組立時に部品や基板に負荷がかからず、応力が発生しません。常温放置または加熱により硬化した後は低弾性の熱伝導性ポリマーとなり、エアギャップの無い高効率の熱インターフェースを提供します。開発品2製品を含む多彩なラインナップを紹介し、



Gap Pad(ギャップパッド) HC5.0: 新製品

熱伝導率 5.0 W/m・K のギャップ充填材料。その高い熱伝導率に加えて、形状追従性が高く、圧縮応力が低いことが特長です。低荷重でも優れた熱特性を発揮するため、組立時に部品や基板に加わるストレスを最低限に抑える必要があるアプリケーションに適しています。また、表面粗さあるいは高低差の大きい表面に対しても形状追従性を維持するため、素早い形状回復および優れた濡れ性を実現します。



回路基板実装材料

ヘンケルの回路基板実装材料は、コモンレール式燃料システム、安全装置、エンジンならびにパワートレイン管理、インフォテインメント、照明など幅広い種類のカーエレクトロニクスやセンサー部品に使用されています。今回は車載向け導電性接着剤、アンダーフィル剤、テクノメルト封止剤を紹介し、



LOCTITE BONDERITE TECHNOMELT TEROSON AQUENCE Ceresit

<展示会概要>

名称: 第9回 [国際]カーエレクトロニクス技術展 ～カーエレ JAPAN～

会期: 2017年1月18日(水)～20日(金) 10:00～18:00 (最終日は 17:00 終了)

会場: 東京ビッグサイト

主催: リードエグジビション ジャパン株式会社

概要: カーエレクトロニクスの進化を支える半導体・電子部材、ソフトウェア、テスト技術などが一堂に出展する本分野世界最大の専門展。

【ヘンケルジャパンブース番号】: 東5ホール E38-31

http://www.automotiveworld.jp/RXJP/RXJP_NepconJapan/documents/2017/INW17_MAP_J_1222.pdf

ヘンケルについて

ヘンケルはブランドとテクノロジーのグローバルリーダーとして、ランドリー&ホームケア、ビューティーケア、アドヒーズテクノロジー(接着技術)の3つの分野で事業展開をしています。ヘンケルは1876年の創立以来、コンシューマービジネスおよび産業分野において、Persil(パーシル)、Schwarzkopf(シュワルツkopf)、Loctite(ロックタイト)などに代表される有名なブランドの数々と共に、グローバルにおけるマーケットリーダーとしての地位を維持しています。ヘンケルの従業員数は約50,000人であり、2015年の売上高は181億ユーロ、調整後の営業利益は29億ユーロを計上しました。ヘンケルの優先株はドイツ株式指数DAXのリストに入っております。

ヘンケルジャパンホームページ: <http://www.henkel.co.jp>

ヘンケルジャパンフェイスブックページ: <http://www.facebook.com/HenkelJapan>

－ 本件に関するお問合せ先 －
ヘンケルジャパン株式会社 接着技術事業部門
マーケティング部 担当: 清晴世
TEL: 045-758-1784 e-mail: haruyo.sei@henkel.com